

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2017-038

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司获得政府补助的基本情况

近日，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家科技重大专项—02 专项国拨经费人民币 7,562,600.00 元，该项资金用于公司联合承担的“12 寸异质晶圆三维晶圆级芯片尺寸封装”项目（课题编号：2014ZX02501008）。通过本项目的实施，公司联合国内集成电路晶圆制造前道厂商，完成了 12 英寸异质晶圆三维集成封装技术的开发，并规模量产应用于背照式（BSI）影像传感器的晶圆级 3D TSV 封装领域，实现了传感器先进封测行业的技术突破与升级。

### 二、补助类型及其对上市公司的影响

公司将根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定确认上述补助并划分补助类型，预计该项补助对公司未来经营和现金流将产生一定的积极影响。

公司对上述政府补助的会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2017 年 9 月 6 日